

**2024-09-04 Qualcomm Daily Media Scan**

[**Qualcomm相關新聞**](#Qualcomm相關新聞)

[**MediaTek相關新聞**](#聯發科相關新聞)

[**無線通訊市場**](#無線通訊市場相關新聞)

[**智慧型手機/消費性電子產品**](#智慧型手機)

[**其他業界重要訊息**](#其他業界重要訊息)

傳Intel可能在2024年9月股東會提出出售Altera與凍結德國設廠的計畫

《產業分析》Q2晶圓代工產值季增近1成 Q3增幅估相當

|  |
| --- |
| **Qualcomm相關新聞** |

|  |
| --- |
| **MediaTek相關新聞** |

|  |
| --- |
| **無線通訊市場相關新聞** |

|  |
| --- |
| **智慧型手機/消費性電子產品** |

|  |
| --- |
| **其他業界重要訊息** |

傳Intel可能在2024年9月股東會提出出售Altera與凍結德國設廠的計畫

2024-09-02 / Cool3c / Chevelle.fu

https://www.cool3c.com/article/223680

雖然Intel在Pat Gelsinger上任之後啟動多項改革計畫，包括重啟製程技術導向的企業文化，與積極推動製程革新與在全球設立工廠，不過對於過去十幾年積習已深的Intel很難在短時間取得立竿見影，除了仍難以與風頭上的NVIDIA在AI有效抗衡以外，加上AMD虎視眈眈地分食Intel自消費級到資料中心CPU市場，Intel在2024年的股價一瀉千里；現在傳出Intel為了繼續進行體制改革，有意在2024年9月的股東會提案將Altera正式賣出，以及考慮暫時凍結原本在德國設廠的計畫。

Intel在2015年以167億美金高調收購當時FPGA第二大廠Altera，原意是與Intel其它解決方案整合提供XPU異構運算戰略，但Intel在2024年3月再度將Altera獨立成子公司，現在則傳出Intel目前由於營運狀況遲遲無法改善，在考慮到核心業務的權重，有意再度將Altera賣出；另外也傳出將提案暫緩斥資300億美金的德國設廠計畫，畢竟日前Intel已傳出有意進一步繼把晶圓製造與代工部門獨立後、循當年AMD模式把晶圓製造部門脫手，也因為此傳聞Intel的股價有一波上漲，若Intel有意脫手晶圓製造與代工業務，那凍結高額的德國設廠計畫也合情合理。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

《產業分析》Q2晶圓代工產值季增近1成 Q3增幅估相當

2024/09/02 / 時報資訊 /   
林資傑

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240902002984-260410?chdtv

TrendForce調查顯示，AI伺服器相關需求續強，且隨著中國大陸618年中消費季到來、及消費性終端庫存水位已在相對健康水位，客戶陸續啟動消費性零組件備貨或庫存回補，使晶圓代工廠接獲急單，帶動第二季稼動率提升。

其中，台積電(2330)由於蘋果進入備貨週期，且AI伺服器相關高速運算（HPC）需求方興未艾，使第二季晶圓出貨量季增3.1％，加上高價先進製程貢獻比重大增，帶動營收季增10.5％至208.2億美元，以62.3％市占穩居龍頭。

三星（Samsong）隨著蘋果iPhone新機展開備貨，包括高通（Quacomm）5/4奈米5G數據機、28/22奈米OLED面板驅動晶片等周邊IC陸續啟動，使第二季營收季增14.2％至38.3億美元，市占11.5％位居第二。

中芯國際受惠中國大陸618銷售季帶動供應鏈急單湧現，在消費性終端周邊IC提前拉貨力道強勁下，使第二季晶圓出貨季增17.7％、營收季增8.6％至19億美元，以5.7％市占穩居第三。

聯電(2303)同樣受惠部分年中消費季急單挹注，尤以電視相關IC較顯著，配合消費性電子所需低階微控制器（MCU）等帶動，使第二季晶圓出貨略增2.6％、營收季增1.1％至17.6億美元，以5.3％市占率排行第四。

格羅方德（GlobalFoundries）第二季晶圓出貨較首季改善，部分動能雖被平均售價（ASP）下滑相抵，營收仍季增5.4％至16.3億元、市占率4.9％位居第五。華虹集團受急單效應帶動，稼動率與出貨皆較首季增加，第二季營收季增5.1％至7.1億美元、市占2.1％排行第六。

高塔半導體（Tower）受惠總晶圓出貨略為改善及產品組合轉佳，第二季營收季增7.3％至3.5億美元，市占1.1％排名第七。

世界先進(5347)受惠備貨急單及去中化電源管理晶片（PMIC）客戶增加，第二季晶圓出貨季增19％、營收季增11.6％至3.4億美元、市占1％躍居第八。

力積電(6770)雖然記憶體晶圓投片需求陸續復甦，但邏輯製程尚無明顯起色，第二季營收小幅季增1.2％至3.2億美元，市占1％排行第九。合肥晶合第二季營收3億美元、季減約3.2％，以0.9％市占排行第十。

而去年第三季一度登上第九名的英特爾晶圓代工服務（IFS），儘管今年首季及第二季營收分達44億、43億美元，但營益率分別為負57％、66％，且考量98～99％營收均來自內部，僅約1％為銷售設備材料、封測服務等外部客戶營收，第二季未能躋身前十大之列。

展望後市，TrendForce認為，儘管全球總經狀態不明朗抑制消費信心，但下半年智慧手機、PC/NB新品發表仍能創造一定程度的系統單晶片（SoC）與周邊IC需求，且AI伺服器相關HPC位處高速成長期，相關需求估將強勁至年底。

TrendForce預期，第三季先進與成熟製程稼動率皆較第二季季改善，預期全球前十大晶圓代工產值將有望進一步成長，且季增幅有望與第二季相當。由於部分先進製程訂單能見度已達2025全年，成為支撐2024年產值成長的關鍵動能。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─